Projet : Excitation des ondes de plasma dans les transistors à haute mobilité.

Transistors avec les capacitances integrées et les bars de Halls couvertes par une grille (photo de chip ci-dessous.

Demande : Réalisation de connexions électriques entre le composant et son support (support DIL - 2me photo ci- dessous)

Dimensions de contacts ~70 μm.



